

产品描述

F2000 具有良好的导热性能。在相对较低的压力下就可以实现低界面热阻性能。应用于功率器件与散热铝片或机器外壳间，可以有效的排除空气，达到很好的填充效果。F2000 是无硅油渗出的导热材料，良好的热稳定性及绝缘性能，使用安全、可靠。同时具有良好的柔軟性和回弹性，起到很好的降低结构应力，保护芯片的效果。



产品特点

- 低热阻
- 无硅油渗出
- 高回弹
- 高可靠性

产品应用

- 安防设备
- 汽车电子
- 网络终端
- 医疗
- 航空航天
- 其他无硅要求设备

产品包装方式

- 片状包装
- 320mm*320mm (0.5≤T<5mm)

性能参数

项目 Item	测试标准和方法 Test standards and methods	技术指标 Values
颜色	目视	灰色
厚度	ASTM D374	0.25~5 mm
玻璃纤维增强	/	N/A
导热系数	ASTM D5470	2 W/m·K
尺寸	ASTM D374	可定制
硬度	ASTM D2240 (Shore 00)	55
密度	ASTM D792	2.8±0.1 g/cm ³
体积电阻率	ASTM D257	10×10 ¹⁰ Ω·cm
击穿电压	ASTM D149	> 6 KV/mm
使用温度	/	-40~125°C
阻燃等级	UL94	V0
储存条件	/	15-30°C
存储时间	/	12个月